

品質管理

品質管理カテゴリー

新唐科技の品質管理の目的は、超大規模集積回路の品質と信頼を確立し、お客様のニーズにお応えすることです。「不具合ゼロ」を目標に、競争力の高い製品を目指し、迅速かつプロフェッショナルなサービスをご提供いたします。弊社の品質管理は「品質コントロール」、「信頼性の保障」および「不良品解析」の3本の柱から成っております。

品質コントロール

新唐科技は各製造工程における品質コントロールシステムを、以下の各段階において実施しております：

材料検査

ウェハー製造プロセス

電気特性検査

パッケージング

全ての製造工程をモニタリングしフィードバックされる各情報に基づき、迅速かつ効率的に問題を検知し解析および計量調整を行います。製造工程ごとに高い完成度への意識を共有し、パーフェクトな生産を目指します。このように高品質で信頼性の高い製品ラインの維持に努めております。

信頼性の保障

新唐科技では、全ライフサイクルを通じ性能の高い製品の維持を目標とした信頼性テストを行っています。各製造工程において十分な検討及び分析がなされ、改善点は製品の更なる品質向上と信頼へと反映されます。弊社製品の信頼性確保は以下の3点に基づいております：

新製品合格テスト

リアルタイムモニタリングによる適合性テスト

ユーザーからフィードバックされる不具合情報

不良品解析

品質保証の重要な一環として不良品解析を行い、不具合の原因究明、改善に努めております。新唐科技では常にSEM、TEM、FIB、SIMS、AES、EDS、AFM、EPMA、Emission Microscope、E-beam prober、Mosaidと、その他の先進設備を用いて、各種部品の解析を行っております。不具合のあるICはコンピューターに詳細な記録が残され、電氣的、物理的検査がなされた後、詳しい報告書が作成されます。改善が施され厳正なる管理の下、正常な状態に保たれます。

パッケージ技術と外注管理

新唐科技はパッケージ会社と提携しており、性能を十分に発揮し得る状態で製品をお客様にお届けしております。資格面で十分な信頼と管理実績を備えたパッケージ会社を選定し、アウトソーシングの面でも質の良いサービスをお約束しております。さらに、新唐科技は厳重なモニタリングシステムを導入しており、パッケージングにおける信頼性の確保に努めております。お客様のニーズに合わせて、各種パッケージング方式に対応できます。

品質保証システム

